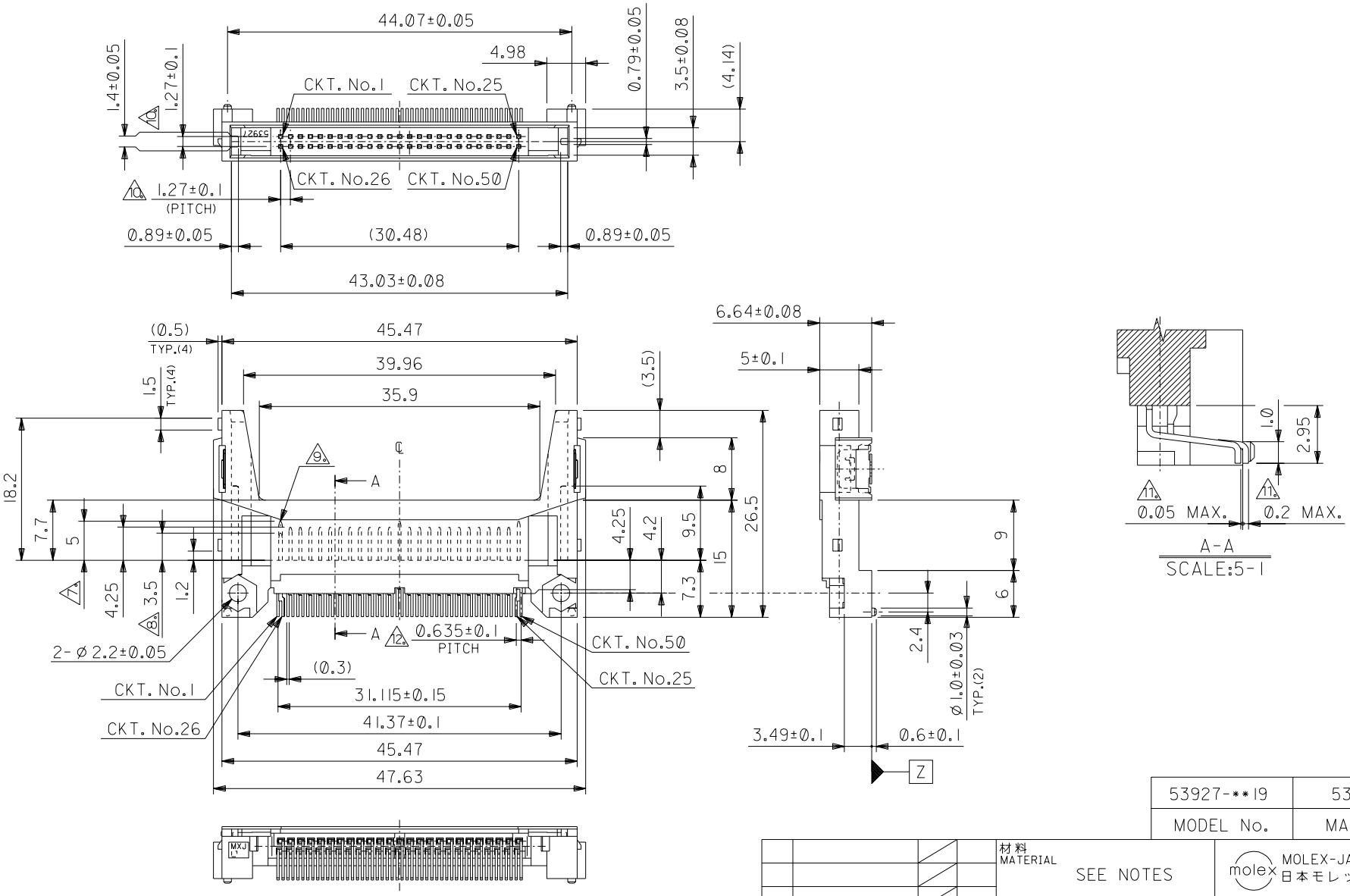
DWG. NO. SD-53927-001



53927-**19	53927-5019
MODEL No.	MATERIAL No.

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 RELEASED (J2004-4268)	T.U. M.S	'04/05/17
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL: SEE NOTES

仕上げ FINISH: SEE NOTES

適用電線範囲 WIRE RANGE: —#—

被覆外径 INS. RANGE: —#—

DRAWN BY '04/05/17 T.UENO

CHK'D BY '04/05/17 M.SASAO

APP'D BY '04/05/17 M.SASAO

尺度 SCALE 2 - 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
CFA CARD CONN.
50P HEADER ASS'Y
(REVERSE TYPE)
-LEAD FREE-

DWG. NO. SD-53927-001 SHEET 1 OF 2 REV 0

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

SD-53927-001.S01

注）

NOTES 1。材質
MATERIAL
ハウジング：ガラス入りＬＣＰ　ＵＬ９４Ｖ－０
HOUSING: LCP G.F. UL94V-0
ピン　　：リン青銅
PIN: PHOSPHOR BRONZE
ネール　：リン青銅
NAIL: PHOSPHOR BRONZE

2。メッキ仕様
PLATING
PIN　接点部　：パラジウムニッケル下地、金メッキ
CONTACT AREA: Au OVER Pd-Ni
半田付け部：錫メッキ
SOLDER TAIL AREA: TIN
下地メッキ：ニッケルメッキ
UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL

NAIL　錫メッキ
TIN
下地メッキ：ニッケルメッキ
UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL

3。推奨基板厚　：t 0.8 MIN.
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: t0.8 MIN.

4。適合カード厚
RECOMMENDED CARD THICKNESS
接続部：3.3±0.1
CONNECTING AREA:3.3±0.1

5。適合カード幅：42.8±0.1
RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8±0.1

6。ハウジング色：白
HOUSING COLOR: WHITE

7。寸法適用極：1,13,38,50
THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 1,13,38 AND 50.

8。寸法適用極：25,26
THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.

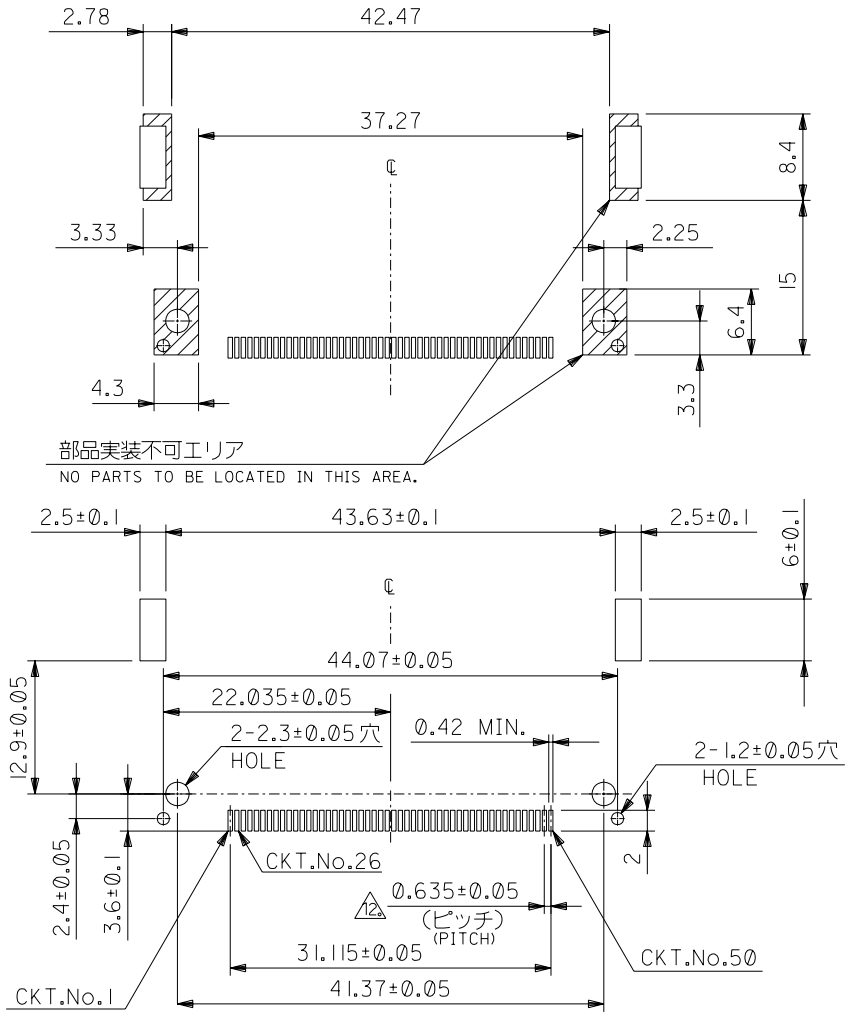
9。ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ 0.1 MAX.とする。
PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.

10。ピン根元に適用する。
THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.

11。ソルダーテールは、Z面を基準とし上へ 0.05 下へ 0.2 の範囲にあり、
且つソルダーテールの平坦度は、0.15 MAX. とし、テール先端にて測定する。
SOLDERTAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF SOLDERTAILS TO BE WITHIN 0.15.
MEASUERMENT POINT IS SOLDERTAILS TIP.

12。公差非累積
NON-CUMULATIVE

13。本製品は　５３９２７－＊＊１０　の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53927-**10.



基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	±0.3				
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25				
10未満 UNDER	±0.2	0	SEE SHEET 1 OF 2	T.U. M.S	'04/05/17
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL	—	
仕上げ FINISH	—	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	
被覆外径 INS. RANGE	—	
DRAWN BY '04/05/17 T.UENO	CHK'D BY '04/05/17 M.SASAO	
APP'D BY '04/05/17 M.SASAO	尺度 SCALE 2 - 1	

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
CFA CARD CONN.
50P HEADER ASS'Y
(REVERSE TYPE)
-LEAD FREE-

DWG. NO. SD-53927-001　SHEET 2 OF 2　REV 0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53927-001

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

SD-53927-001.S02

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9